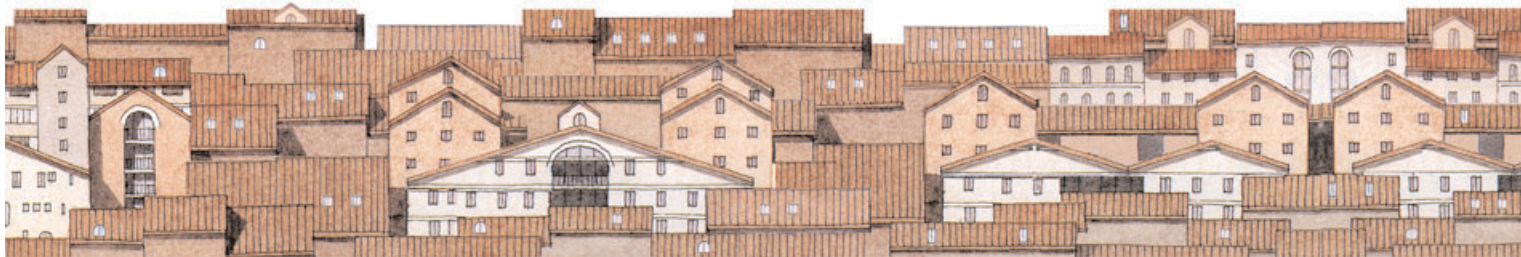


# *soluzioni* **TETTO e PARETI**



## **L'INVOLUCRO EDILIZIO: PROTEZIONE E RISPARMIO ENERGETICO**

**Giovedì 21 Febbraio 2008 - ore 15.00**

**CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII**

**SALA OGGIONI** Via Papa Giovanni XXIII, 106

**BERGAMO**

**INVITO**

## *soluzioni* **TETTO e PARETI** L'INVOLUCRO EDILIZIO: PROTEZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

Le prestazioni dell'involucro nell'architettura contemporanea costituiscono banco di prova per la collaborazione di competenze specialistiche quali la normativa acustica e antincendio, le prestazioni energetiche intese come isolamento ed inerzia termiche, l'ecosostenibilità e la biocompatibilità dei materiali adottati. Una rinnovata cultura dell'abitare si coniuga con le aspettative indifferibili di una drastica riduzione dei consumi e quindi di gestione della spesa. Sistemi integrati attivi e passivi, che sfruttino fonti energetiche rinnovabili, costituiscono la nuova risorsa a cui il progettista architettonico deve attingere. Aggiornate conoscenze sono, dunque, indispensabili strumenti per un corretto esercizio professionale.

Giovedì 21 Febbraio 2008 ore 15.00 - Centro Congressi Giovanni XXIII - Sala Oggioni - Bergamo



Il seminario è un'importante occasione di aggiornamento professionale per Funzionari delle Amministrazioni Pubbliche, Professionisti e Progettisti operanti nelle Imprese Edili

con il patrocinio di



ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO



COLLEGIO DEI GEOMETRI  
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ORE 15.00 SALUTO AI PARTECIPANTI E INTRODUZIONE AI LAVORI

**Donatella Guzzoni**, *Presidente Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Bergamo*

**Achille Bonardi**, *Presidente Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Bergamo*

**Renato Ferrari**, *Presidente Collegio dei Geometri  
della Provincia di Bergamo*

## INTERVENTI

- ORE 15.15 **Massa termica e risparmio energetico**  
**Monica Lavagna**, *Politecnico di Milano, Dipartimento BEST*
- ORE 15.50 **L'integrazione razionale delle diverse prestazioni nell'involucro edilizio**  
**Termica, Acustica, Antincendio, le nuove norme, le responsabilità, le soluzioni per la sostenibilità**  
**Paolo Donelli**, *Eraclit-Venier*  
**L'acustica negli edifici: normative e soluzioni di cantiere**  
**Paolo Giacomini**, *Membro dell'Associazione Italiana di Acustica, Socio Fondatore dell'Assoacustici, Vicepresidente della Commissione Acustica dell'UNI*
- ORE 17.00 **Costruire con il legno: un materiale ecocompatibile**  
**Leyla Arone**, *Kaufmann Canducci*  
**Andrea Piero Merlo**, *Ingegnere Libero Professionista, esperto CasaClima*
- ORE 17.30 **Innovazioni tecniche per il risparmio energetico: il fotovoltaico nelle coperture**  
**Caterina Gargari**, *Dipartimento Tecnologie dell'Architettura e Design "P. Spadolini", Università di Firenze*

ORE 18.00 CONCLUSIONI - Seguirà dibattito

## ORE 14.45 REGISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALE TECNICO INFORMATIVO



- 1 Nuova energia ai tuoi progetti  
Picasisemi
- 2 La soluzione costruttiva per la qualità della vita e il risparmio energetico  
Picablock
- 3 Book fotografico e cd-rom contenenti le attività di ricerca e i casi studio realizzati dalla Kaufmann-Canducci
- 4 Manuali tecnici Eraclit per la protezione antincendio, acustica e termica

Il convegno è gratuito

Per avere diritto ai volumi in omaggio è necessario confermare la propria presenza alla segreteria organizzativa **entro martedì 19 febbraio 2008 - fax 059356096 unimark@tsc4.com**

NEL PIENO RISPETTO DELL'ART. 13 - D. Lgs. 196/2003, LA UNI PUBBLICITA' & MARKETING DICHIARA CHE I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI PER L'INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO, PUBBLICITARIO O PROMOZIONALE E CHE SARA' POSSIBILE RICHIEDERE LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI SCRIVENDO A: INDUSTRIE PICA - PICASISTEMI - CANDUCCI HOLZ SERVICE - ERACLIT-VENIER

# *soluzioni* **TETTO e PARETI**

L'INVOLUCRO EDILIZIO: PROTEZIONE E RISPARMIO ENERGETICO

UNIMKT 2008/02



Il convegno è realizzato con il contributo di



INDUSTRIE PICA S.p.A.  
[www.pica.it](http://www.pica.it)  
[info@pica.it](mailto:info@pica.it)



PICASISTEMI S.r.l.  
[www.picasistemi.it](http://www.picasistemi.it)  
[info@picasistemi.it](mailto:info@picasistemi.it)



KAUFMANN ITALIA  
[www.kaufmannitalia.com](http://www.kaufmannitalia.com)  
[kaufmann@kaufmannitalia.com](mailto:kaufmann@kaufmannitalia.com)



ERACLIT-VENIER S.p.A.  
[www.eraclit.eu](http://www.eraclit.eu)  
[eraclit@eraclit.it](mailto:eraclit@eraclit.it)